|  |
| --- |
| [2024-2030年中国半导体设备行业全面调研与发展趋势分析报告](https://www.20087.com/8/60/BanDaoTiSheBeiDeFaZhanQuShi.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2024-2030年中国半导体设备行业全面调研与发展趋势分析报告](https://www.20087.com/8/60/BanDaoTiSheBeiDeFaZhanQuShi.html) |
| 报告编号： | 2653608　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：9000 元　　纸介＋电子版：9200 元 |
| 优惠价： | 电子版：8000 元　　纸介＋电子版：8300 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/8/60/BanDaoTiSheBeiDeFaZhanQuShi.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　半导体设备行业是全球高科技产业的基石，随着5G、人工智能、物联网等新技术的兴起，对高性能、高集成度芯片的需求持续增长。近年来，光刻机、蚀刻机、沉积设备、检测设备等半导体生产设备的技术迭代迅速，尤其是极紫外光刻（EUV）技术的成熟，推动了芯片制造向更精细的制程节点发展。同时，半导体设备的自动化和智能化水平不断提高，减少了人为错误，提升了生产效率。
　　未来，半导体设备将更加注重先进制程的支持和设备的可持续性。先进制程方面，随着芯片尺寸逼近物理极限，设备厂商将致力于开发下一代光刻技术，如高NA EUV光刻和纳米压印技术，以实现更小的晶体管尺寸。可持续性方面，设备将采用更高效的能源管理，减少废水和废气排放，同时设备的循环利用和升级将得到更多关注，以减少资源消耗和环境影响。
　　《[2024-2030年中国半导体设备行业全面调研与发展趋势分析报告](https://www.20087.com/8/60/BanDaoTiSheBeiDeFaZhanQuShi.html)》通过严谨的内容、翔实的分析、权威的数据和直观的图表，全面解析了半导体设备行业的市场规模、需求变化、价格波动以及产业链构成。半导体设备报告深入剖析了当前市场现状，科学预测了未来半导体设备市场前景与发展趋势，特别关注了半导体设备细分市场的机会与挑战。同时，对半导体设备重点企业的竞争地位、品牌影响力和市场集中度进行了全面评估。半导体设备报告是行业内企业、投资公司及政府部门制定战略、规避风险、优化投资决策的重要参考。

第一章 半导体设备行业基本概述
　　1.1 半导体的定义和分类
　　　　1.1.1 半导体的定义
　　　　1.1.2 半导体的分类
　　　　1.1.3 半导体的应用
　　1.2 半导体设备行业概述
　　　　1.2.1 行业概念界定
　　　　1.2.2 行业主要分类

第二章 2019-2024年中国半导体设备行业发展环境PEST分析
　　2.1 政策环境（Political）
　　　　2.1.1 半导体产业政策汇总
　　　　2.1.2 半导体制造利好政策
　　　　2.1.3 工业半导体政策动态
　　　　2.1.4 产业投资基金的支持
　　2.2 经济环境（Economic）
　　　　2.2.1 宏观经济发展概况
　　　　2.2.2 工业经济运行情况
　　　　2.2.3 经济转型升级发展
　　　　2.2.4 未来经济发展展望
　　2.3 社会环境
　　　　2.3.1 移动网络运行状况
　　　　2.3.2 研发经费投入增长
　　　　2.3.3 科技人才队伍壮大
　　2.4 技术环境（Technological）
　　　　2.4.1 企业研发投入
　　　　2.4.2 技术迭代历程
　　　　2.4.3 企业专利状况

第三章 2019-2024年半导体产业链发展状况
　　3.1 半导体产业链分析
　　　　3.1.1 半导体产业链结构
　　　　3.1.2 半导体产业链流程
　　　　3.1.3 半导体产业链转移
　　3.2 2019-2024年全球半导体市场总体分析
　　　　3.2.1 市场销售规模
　　　　3.2.2 产业研发投入
　　　　3.2.3 行业产品结构
　　　　3.2.4 区域市场格局
　　　　3.2.5 市场竞争状况
　　　　3.2.6 资本支出预测
　　　　3.2.7 产业发展前景
　　3.3 2019-2024年中国半导体市场运行状况
　　　　3.3.1 产业发展历程
　　　　3.3.2 产业发展态势
　　　　3.3.3 产业销售规模
　　　　3.3.4 市场规模现状
　　　　3.3.5 产业区域分布
　　　　3.3.6 市场机会分析
　　3.4 2019-2024年中国IC设计行业发展分析
　　　　3.4.1 行业发展历程
　　　　3.4.2 市场发展规模
　　　　3.4.3 企业发展状况
　　　　3.4.4 产业地域分布
　　　　3.4.5 细分市场发展
　　3.5 2019-2024年中国IC制造行业发展分析
　　　　3.5.1 制造工艺分析
　　　　3.5.2 晶圆加工技术
　　　　3.5.3 市场发展规模
　　　　3.5.4 企业排名状况
　　　　3.5.5 行业发展措施
　　3.6 2019-2024年中国IC封装测试行业发展分析
　　　　3.6.1 封装基本介绍
　　　　3.6.2 封装技术趋势
　　　　3.6.3 芯片测试原理
　　　　3.6.4 芯片测试分类
　　　　3.6.5 市场发展规模
　　　　3.6.6 企业排名状况
　　　　3.6.7 技术发展趋势

第四章 2019-2024年半导体设备行业发展综合分析
　　4.1 2019-2024年全球半导体设备市场发展形势
　　　　4.1.1 市场销售规模
　　　　4.1.2 市场结构分析
　　　　4.1.3 市场区域格局
　　　　4.1.4 重点厂商介绍
　　　　4.1.5 市场发展预测
　　4.2 2019-2024年中国半导体设备市场发展现状
　　　　4.2.1 市场销售规模
　　　　4.2.2 市场需求分析
　　　　4.2.3 市场竞争态势
　　　　4.2.4 市场国产化率
　　　　4.2.5 行业发展成就
　　4.3 半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析
　　　　4.3.1 设备基本概述
　　　　4.3.2 核心环节分析
　　　　4.3.3 主要厂商介绍
　　　　4.3.4 市场发展规模
　　4.4 半导体产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析
　　　　4.4.1 设备基本概述
　　　　4.4.2 市场发展规模
　　　　4.4.3 市场价值构成
　　　　4.4.4 市场竞争格局

第五章 2019-2024年半导体光刻设备市场发展分析
　　5.1 半导体光刻环节基本概述
　　　　5.1.1 光刻工艺重要性
　　　　5.1.2 光刻工艺的原理
　　　　5.1.3 光刻工艺的流程
　　5.2 半导体光刻技术发展分析
　　　　5.2.1 光刻技术原理
　　　　5.2.2 光刻技术历程
　　　　5.2.3 光学光刻技术
　　　　5.2.4 EUV光刻技术
　　　　5.2.5 X射线光刻技术
　　　　5.2.6 纳米压印光刻技术
　　5.3 2019-2024年光刻机市场发展综述
　　　　5.3.1 光刻机工作原理
　　　　5.3.2 光刻机发展历程
　　　　5.3.3 光刻机产业链条
　　　　5.3.4 光刻机市场规模
　　　　5.3.5 光刻机竞争格局
　　　　5.3.6 光刻机技术差距
　　5.4 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况
　　　　5.4.1 EUV光刻机基本介绍
　　　　5.4.2 典型企业经营状况
　　　　5.4.3 EUV光刻机需求企业
　　　　5.4.4 EUV光刻机研发分析

第六章 2019-2024年半导体刻蚀设备市场发展分析
　　6.1 半导体刻蚀环节基本概述
　　　　6.1.1 刻蚀工艺介绍
　　　　6.1.2 刻蚀工艺分类
　　　　6.1.3 刻蚀工艺参数
　　6.2 干法刻蚀工艺发展优势分析
　　　　6.2.1 干法刻蚀优点分析
　　　　6.2.2 干法刻蚀应用分类
　　　　6.2.3 干法刻蚀技术演进
　　6.3 2019-2024年全球半导体刻蚀设备市场发展状况
　　　　6.3.1 市场发展规模
　　　　6.3.2 市场竞争格局
　　　　6.3.3 设备研发支出
　　6.4 2019-2024年中国半导体刻蚀设备市场发展状况
　　　　6.4.1 市场发展规模
　　　　6.4.2 企业发展现状
　　　　6.4.3 市场需求状况
　　　　6.4.4 市场空间测算

第七章 2019-2024年半导体清洗设备市场发展分析
　　7.1 半导体清洗环节基本概述
　　　　7.1.1 清洗环节的重要性
　　　　7.1.2 清洗工艺类型比较
　　　　7.1.3 清洗设备技术原理
　　　　7.1.4 清洗设备主要类型
　　　　7.1.5 清洗设备主要部件
　　7.2 2019-2024年半导体清洗设备市场发展状况
　　　　7.2.1 市场发展规模
　　　　7.2.2 市场竞争格局
　　　　7.2.3 市场发展机遇
　　　　7.2.4 市场发展趋势
　　7.3 半导体清洗机领先企业布局状况
　　　　7.3.1 迪恩士公司
　　　　7.3.2 盛美半导体
　　　　7.3.3 国产化布局

第八章 2019-2024年半导体测试设备市场发展分析
　　8.1 半导体测试环节基本概述
　　　　8.1.1 测试流程介绍
　　　　8.1.2 前道工艺检测
　　　　8.1.3 中后道的测试
　　8.2 2019-2024年半导体测试设备市场发展状况
　　　　8.2.1 市场发展规模
　　　　8.2.2 市场竞争格局
　　　　8.2.3 细分市场结构
　　　　8.2.4 设备制造厂商
　　　　8.2.5 市场空间测算
　　8.3 半导体测试设备重点企业发展启示
　　　　8.3.1 泰瑞达
　　　　8.3.2 爱德万
　　8.4 半导体测试核心设备发展分析
　　　　8.4.1 测试机
　　　　8.4.2 分选机
　　　　8.4.3 探针台

第九章 2019-2024年半导体产业其他设备市场发展分析
　　9.1 单晶炉设备
　　　　9.1.1 设备基本概述
　　　　9.1.2 市场发展现状
　　　　9.1.3 主要企业分析
　　　　9.1.4 市场前景展望
　　9.2 氧化/扩散设备
　　　　9.2.1 设备基本概述
　　　　9.2.2 市场发展现状
　　　　9.2.3 主要企业分析
　　　　9.2.4 核心产品介绍
　　9.3 薄膜沉积设备
　　　　9.3.1 设备基本概述
　　　　9.3.2 市场发展现状
　　　　9.3.3 主要企业分析
　　　　9.3.4 市场前景展望
　　9.4 化学机械抛光设备
　　　　9.4.1 设备基本概述
　　　　9.4.2 市场发展现状
　　　　9.4.3 市场竞争格局
　　　　9.4.4 主要企业分析

第十章 2019-2024年国外半导体设备重点企业经营状况
　　10.1 应用材料
　　　　10.1.1 企业发展概况
　　　　10.1.2 企业发展历程
　　　　10.1.3 企业经营状况
　　　　10.1.4 企业核心产品
　　　　10.1.5 企业发展前景
　　10.2 泛林集团
　　　　10.2.1 企业发展概况
　　　　10.2.2 企业经营状况
　　　　10.2.3 企业核心产品
　　　　10.2.4 企业发展前景
　　10.3 阿斯麦
　　　　10.3.1 企业发展概况
　　　　10.3.2 企业经营状况
　　　　10.3.3 企业核心产品
　　　　10.3.4 企业发展前景
　　10.4 东京电子
　　　　10.4.1 企业发展概况
　　　　10.4.2 企业经营状况
　　　　10.4.3 企业核心产品
　　　　10.4.4 企业发展前景

第十一章 2019-2024年国内半导体设备重点企业经营状况
　　11.1 晶盛机电
　　　　11.1.1 企业发展概况
　　　　11.1.2 经营效益分析
　　　　11.1.3 业务经营分析
　　　　11.1.4 财务状况分析
　　　　11.1.5 核心竞争力分析
　　　　11.1.6 公司发展战略
　　　　11.1.7 未来前景展望
　　11.2 中电科电子
　　　　11.2.1 企业发展概况
　　　　11.2.2 企业核心产品
　　　　11.2.3 企业参与项目
　　　　11.2.4 产品研发动态
　　　　11.2.5 企业发展前景
　　11.3 捷佳伟创
　　　　11.3.1 企业发展概况
　　　　11.3.2 经营效益分析
　　　　11.3.3 业务经营分析
　　　　11.3.4 财务状况分析
　　　　11.3.5 核心竞争力分析
　　　　11.3.6 公司发展战略
　　　　11.3.7 未来前景展望
　　11.4 中微公司
　　　　11.4.1 企业发展概况
　　　　11.4.2 企业产品分析
　　　　11.4.3 企业经营状况
　　　　11.4.4 企业竞争优势
　　　　11.4.5 公司发展战略
　　　　11.4.6 未来前景展望
　　11.5 北方华创
　　　　11.5.1 企业发展概况
　　　　11.5.2 企业核心产品
　　　　11.5.3 经营效益分析
　　　　11.5.4 业务经营分析
　　　　11.5.5 财务状况分析
　　　　11.5.6 核心竞争力分析
　　　　11.5.7 公司发展战略
　　　　11.5.8 未来前景展望
　　11.6 上海微电子
　　　　11.6.1 企业发展概况
　　　　11.6.2 企业发展历程
　　　　11.6.3 企业参与项目
　　　　11.6.4 企业创新能力
　　　　11.6.5 企业发展地位

第十二章 对半导体设备行业投资价值分析
　　12.1 半导体设备企业并购市场发展状况
　　　　12.1.1 企业并购历史回顾
　　　　12.1.2 行业并购特征分析
　　　　12.1.3 企业并购动机归因
　　12.2 中国半导体设备市场投资机遇分析
　　　　12.2.1 行业投资机会分析
　　　　12.2.2 建厂加速拉动需求
　　　　12.2.3 产业政策扶持发展
　　12.3 对半导体设备投资价值评估及建议
　　　　12.3.1 投资价值综合评估
　　　　12.3.2 行业投资特点分析
　　　　12.3.3 行业投资风险预警
　　　　12.3.4 行业投资策略建议

第十三章 中国行业标杆企业项目投资建设案例深度解析
　　13.1 半导体湿法设备制造项目
　　　　13.1.1 项目基本概述
　　　　13.1.2 资金需求测算
　　　　13.1.3 投资价值分析
　　　　13.1.4 建设内容规划
　　　　13.1.5 经济效益分析
　　13.2 半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目
　　　　13.2.1 项目基本概述
　　　　13.2.2 资金需求测算
　　　　13.2.3 投资价值分析
　　　　13.2.4 项目实施必要性
　　　　13.2.5 实施进度安排
　　　　13.2.6 经济效益分析
　　13.3 光刻机产业化项目
　　　　13.3.1 项目基本概述
　　　　13.3.2 资金需求测算
　　　　13.3.3 投资价值分析
　　　　13.3.4 建设内容规划
　　　　13.3.5 项目实施必要性
　　　　13.3.6 经济效益分析

第十四章 (中⋅智⋅林)对2024-2030年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析
　　14.1 中国半导体产业未来发展趋势
　　　　14.1.1 技术发展利好
　　　　14.1.2 自主创新发展
　　　　14.1.3 产业地位提升
　　　　14.1.4 产业应用前景
　　14.2 中国半导体设备行业发展前景展望
　　　　14.2.1 市场应用需求
　　　　14.2.2 行业发展机遇
　　　　14.2.3 产业发展前景
　　14.3 对2024-2030年中国半导体设备行业预测分析
　　　　14.3.1 2024-2030年中国半导体设备行业影响因素分析
　　　　14.3.2 2024-2030年中国大陆半导体设备销售规模预测

图表目录
　　图表 1 半导体分类结构图
　　图表 2 半导体分类
　　图表 3 半导体分类及应用
　　图表 4 半导体设备构成
　　图表 5 IC芯片制造核心工艺主要设备全景图
　　图表 6 《中国制造2024年》半导体产业政策目标与政策支持
　　图表 7 2024-2030年IC产业政策目标与发展重点
　　图表 8 一期大基金投资各领域份额占比
　　图表 9 2019-2024年国内生产总值及其增长速度
　　图表 10 2019-2024年三次产业增加值占国内生产总值比重
　　图表 11 2024年中国GDP核算数据
　　图表 12 2024年规模以上工业增加至同比增长速度
　　图表 13 2024年规模以上工业生产主要数据
　　图表 14 2023-2024年规模以上工业增加值同比增长速度
　　图表 15 2024年规模以上工业生产主要数据
　　图表 16 2019-2024年中国网民规模和互联网普及率
　　图表 17 2019-2024年手机网民规模及其占网民比例
　　图表 18 2019-2024年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度
　　图表 19 2024年专利申请、授权和有效专利情况
　　图表 20 2019-2024年海外半导体设备企业研发投入强度
　　图表 21 半导体企业技术迭代图
　　图表 22 半导体产业链示意图
　　图表 23 半导体上下游产业链
　　图表 24 半导体产业转移和产业分工
　　图表 25 集成电路产业转移状况
　　图表 26 全球主要半导体厂商
　　图表 27 2019-2024年全球半导体市场营收规模及增长率
　　图表 28 2024年全球研发支出前十大排名
　　图表 29 2019-2024年全球集成电路占半导体比重变化情况
　　图表 30 2024年全球半导体细分产品规模分布
　　图表 31 2024年全球半导体市场区域分布
　　图表 32 2019-2024年全球半导体市场区域增长
　　图表 33 2024年全球营收前10大半导体厂商
　　图表 34 2024-2030年全球半导体资本支出与设备支出预测
　　图表 35 国内半导体发展阶段
　　图表 36 国家集成电路产业发展推进纲要
　　图表 37 2019-2024年中国半导体产业销售额
　　图表 38 2019-2024年中国半导体市场规模
　　图表 39 2024年和2024年中国集成电路产量地区分布图示
　　图表 40 IC设计的不同阶段
　　图表 41 2019-2024年中国IC设计行业销售额及增长率
　　图表 42 2019-2024年营收过亿企业数量统计
　　图表 43 2023-2024年过亿元企业城市分布
　　图表 44 2024年各营收区间段企业数量分布
　　图表 45 2023-2024年中国大陆各区域IC设计营收分析
　　图表 46 2024年各区域销售额及占比分析
　　图表 47 10大IC设计城市增速比较
　　图表 48 2023-2024年IC设计行业营收排名前十的城市
　　图表 49 从二氧化硅到“金属硅”
　　图表 50 从“金属硅”到多晶硅
　　图表 51 从晶柱到晶圆
　　图表 52 2019-2024年中国IC制造业销售额及增长率
　　图表 53 2024年中国集成电路制造十大企业
　　图表 54 现代电子封装包含的四个层次
　　图表 55 根据封装材料分类
　　图表 56 目前主流市场的两种封装形式
　　图表 57 封装技术微型化发展
　　图表 58 SOC与SIP区别
　　图表 59 封测技术发展重构了封测厂的角色
　　图表 60 2024-2030年先进封装市场规模预测
　　图表 61 2024-2030年FOWLP市场空间
　　图表 62 2019-2024年中国IC封装测试业销售额及增长率
　　图表 63 2024年中国集成电路封装测试十大企业
　　图表 64 2023-2024年全球半导体设备市场规模
　　图表 65 2019-2024年全球半导体设备市场结构（按销售额统计）
　　图表 66 2019-2024年半导体制造前道设备市场规模
　　图表 67 2019-2024年全球半导体设备销售额的地区结构
　　图表 68 2024年全球半导体设备市场份额
　　图表 69 2024年全球主要地区半导体设备市场规模
　　图表 70 2019-2024年全球半导体设备支出
　　图表 71 2019-2024年中国大陆半导体设备销售额及增速
　　图表 72 晶圆制造各环节设备投资占比
　　图表 73 2024年中国与世界半导体设备前十大厂商
　　图表 74 开始步入生产线验证的应用于14nm的国产设备
　　图表 75 光刻、刻蚀、成膜成本占比最高
　　图表 76 硅片制造设备厂商
　　图表 77 晶圆制造设备价值构成
　　图表 78 各种类型的CVD反应器及其主要特点
　　图表 79 2024年全球集成电路设备价值构成
　　图表 80 2024年全球集成电路晶圆加工设备价值构成
　　图表 81 全球集成电路晶圆加工设备供应商行业集中度
　　图表 82 我国集成电路晶圆加工设备供应商分布
　　图表 83 在硅片表面构建半导体器件的过程
　　图表 84 正性光刻与负性光刻对比
　　图表 85 旋转涂胶步骤
　　图表 86 涂胶设备构成
　　图表 87 光刻原理图
　　图表 88 显影过程示意图
　　图表 89 干法（物理）、湿法（化学）刻蚀原理示意图
　　图表 90 半导体光刻技术原理
　　图表 91 光刻技术曝光光源发展历程
　　图表 92 光刻机工作原理图
　　图表 93 晶体管内部结构图
　　图表 94 光刻机产品发展历程
　　图表 95 步进式投影示意图
　　图表 96 浸没式光刻机原理
　　图表 97 光刻机产业链及关键企业
　　图表 98 2019-2024年全球光刻机台出货比重
　　图表 99 2019-2024年全球光刻销售金额比重
　　图表 100 2024年全球光刻机总销售情况
　　图表 101 2019-2024年全球光刻机总销售情况
　　图表 102 2019-2024年全球光刻机市场份额
　　图表 103 刻蚀工艺原理
　　图表 104 刻蚀分类示意图
　　图表 105 主要刻蚀参数
　　图表 106 干法刻蚀优点分析
　　图表 107 干法刻蚀的应用
　　图表 108 传统反应离子刻蚀机示意图
　　图表 109 电子回旋加速振荡刻蚀机（ECR）示意图
　　图表 110 电容、电感耦合等离子体刻蚀机（CCP、ICP）示意图
　　图表 111 双等离子体源刻蚀机示意图
　　图表 112 原子层刻蚀（ALE）工艺示意图
　　图表 113 2024年全球半导体晶圆处理设备中刻蚀设备价值量占比
　　图表 114 前道工序设备价值量统计
　　图表 115 2019-2024年全球刻蚀设备市场规模
　　图表 116 2024年全球刻蚀设备市场份额分布情况
　　图表 117 2019-2024年应用材料、拉姆研究、东京电子研发费用及营收占比情况
　　图表 118 刻蚀设备龙头公司收购相关标的情况
　　图表 119 2019-2024年中国刻蚀设备市场规模
　　图表 120 实现销售的12英寸国产晶圆生产关键设备
　　图表 121 2024-2030年中国、外国公司对中国半导体工厂投资额对比
　　图表 122 中国部分在建或计划建设半导体工厂
　　图表 123 2024-2030年中国半导体核心设备国产化率
　　图表 124 晶圆制造工艺中清洗步骤和目的
　　图表 125 各类常见的半导体清洗工艺对比
　　图表 126 石英加热槽结构
　　图表 127 兆声清洗槽结构
　　图表 128 清洗步骤约占整体步骤比重
　　图表 129 制程结构升级下清洗设备市场未来趋势
　　图表 130 半导体测试流程及设备示意图
　　图表 131 晶圆制造的前道工艺检测环节设备一览
　　图表 132 IC产品的不同电学测试
　　图表 133 集成电路的生产流程及性能测试环节示意图
　　图表 134 2019-2024年中国半导体测试设备市场规模及增长
　　图表 135 2024年中国半导体测试设备产品结构
　　图表 136 中国半导体测试设备主要制造商概况
　　图表 137 2023-2024年中国半导体测试设备市场需求测算
　　图表 138 泰瑞达半导体测试设备产品一览
　　图表 139 泰瑞达公司发展历程
　　图表 140 泰瑞达并购史
　　图表 141 2024年爱德万测试发布针对SSD、汽车SoC及DRAM领域三大产品系列升级
　　图表 142 2019-2024年爱德万营收及同比情况
　　图表 143 2019-2024年爱德万净利润及同比情况
　　图表 144 2019-2024年爱德万销售额按业务分布占比情况
　　图表 145 2019-2024年中国半导体测试机市场规模及增长
　　图表 146 2024年中国半导体测试机产品销售情况
　　图表 147 2024年中国半导体测试机产品结构分布
　　图表 148 2024年中国半导体测试机市场品牌结构
　　图表 149 半导体测试机技术难点
　　图表 150 重力式、转塔式、平移式分选机性能比较
　　图表 151 分选机技术难点
　　图表 152 国内外先进厂商分选机性能比较
　　图表 153 探针台主要结构示意图
　　图表 154 探针台技术难点
　　图表 155 国内外先进厂商探针台对比
　　图表 156 晶盛机电主要产品
　　图表 157 北方华创氧化/扩散设备
　　图表 158 薄膜生长设备
　　图表 159 AMAT历次收购
　　图表 160 2023-2024年应用材料公司综合收益表
　　图表 161 2023-2024年应用材料公司分部资料
　　图表 162 2023-2024年应用材料公司收入分地区资料
　　图表 163 2023-2024年应用材料公司综合收益表
　　图表 164 2023-2024年应用材料公司分部资料
　　图表 165 2023-2024年应用材料公司收入分地区资料
　　图表 166 2023-2024年应用材料公司综合收益表
　　图表 167 2023-2024年应用材料公司分部资料
　　图表 168 2023-2024年应用材料公司收入分地区资料
　　图表 169 2023-2024年林氏研究公司综合收益表
　　图表 170 2023-2024年林氏研究公司收入分地区资料
　　图表 171 2023-2024年林氏研究公司综合收益表
　　图表 172 2023-2024年林氏研究公司收入分地区资料
　　图表 173 2023-2024年林氏研究公司综合收益表
　　图表 174 2023-2024年林氏研究公司收入分地区资料
　　图表 175 2023-2024年阿斯麦公司综合收益表
　　图表 176 2023-2024年阿斯麦公司收入分地区资料
　　图表 177 2023-2024年阿斯麦公司综合收益表
　　图表 178 2023-2024年阿斯麦公司收入分地区资料
　　图表 179 2023-2024年阿斯麦公司综合收益表
　　图表 180 2023-2024年东京电子有限公司综合收益表
　　图表 181 2023-2024年东京电子有限公司分部资料
　　图表 182 2023-2024年东京电子有限公司收入分地区资料
　　图表 183 2023-2024年东京电子有限公司综合收益表
　　图表 184 2023-2024年东京电子有限公司分部资料
　　图表 185 2023-2024年东京电子有限公司收入分地区资料
　　图表 186 2023-2024年东京电子有限公司综合收益表
　　图表 187 2023-2024年东京电子有限公司分部资料
　　图表 188 2023-2024年东京电子有限公司收入分地区资料
　　图表 189 东京电子公司产品示意图
　　图表 190 2019-2024年东京电子发明者和专利数量对比
　　图表 191 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司总资产及净资产规模
　　图表 192 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司营业收入及增速
　　图表 193 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司净利润及增速
　　图表 194 2023-2024年浙江晶盛机电股份有限公司营业收入分行业、产品、地区
　　图表 195 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司营业利润及营业利润率
　　图表 196 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司净资产收益率
　　图表 197 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司短期偿债能力指标
　　图表 198 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司资产负债率水平
　　图表 199 2019-2024年浙江晶盛机电股份有限公司运营能力指标
　　图表 200 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司总资产及净资产规模
　　图表 201 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司营业收入及增速
　　图表 202 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司净利润及增速
　　图表 203 2023-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司营业收入分行业、产品、地区
　　图表 204 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司营业利润及营业利润率
　　图表 205 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司净资产收益率
　　图表 206 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司短期偿债能力指标
　　图表 207 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司资产负债率水平
　　图表 208 2019-2024年深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司运营能力指标
　　图表 209 2019-2024年中微半导体设备（上海）股份有限公司利润
　　图表 210 2019-2024年中微半导体设备（上海）股份有限公司营业收入
　　图表 211 2019-2024年中微半导体设备（上海）股份有限公司营业收入分产品
　　图表 212 2019-2024年中微半导体设备（上海）股份有限公司营业收入分地区
　　图表 213 北方华创产品线
　　图表 214 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司总资产及净资产规模
　　图表 215 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司营业收入及增速
　　图表 216 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司净利润及增速
　　图表 217 2023-2024年北方华创科技集团股份有限公司营业收入分行业、产品、地区
　　图表 218 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司营业利润及营业利润率
　　图表 219 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司净资产收益率
　　图表 220 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司短期偿债能力指标
　　图表 221 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司资产负债率水平
　　图表 222 2019-2024年北方华创科技集团股份有限公司运营能力指标
　　图表 223 2019-2024年上海微电子发布的专利数量
　　图表 224 2019-2024年半导体设备企业并购阶段回顾
　　图表 225 2019-2024年半导体设备企业现金及现金等价物
　　图表 226 2019-2024年行业并购数量与行业销售额增长率
　　图表 227 半导体设备企业并购被并购方地域分布
　　图表 228 半导体设备公司并购的数量和金额特征
　　图表 229 国内主要半导体设备企业
　　图表 230 2019-2024年中国新开工晶圆厂数量
　　图表 231 2024年中国大陆在建/拟建晶圆厂统计
　　图表 232 国家支持集成电路产业发展的部分重点政策
　　图表 233 中国半导体设备上市公司营收保持快速增长
　　图表 234 半导体湿法设备制造项目募集资金总额
　　图表 235 2019-2024年全球半导体市场规模情况
　　图表 236 2019-2024年我国集成电路产业规模情况
　　图表 237 2024-2030年全球晶圆总出货量情况
　　图表 238 半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目计划用资金情况
　　图表 239 光刻机产业化项目资金需求及应用方向
　　图表 240 半导体产业应用市场前景
　　图表 241 对2024-2030年中国大陆半导体设备销售规模预测
略……

了解《[2024-2030年中国半导体设备行业全面调研与发展趋势分析报告](https://www.20087.com/8/60/BanDaoTiSheBeiDeFaZhanQuShi.html)》，报告编号：2653608，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：<https://www.20087.com/8/60/BanDaoTiSheBeiDeFaZhanQuShi.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！